



Первый тип Underfill материала наносится до установки BGA микросхемы и выступает в качестве флюсующего компонента во время пайки и в качестве влагозащитного и клеящего материала после отверждения. Отверждается с паяльной пастой в едином цикле в процессе пайки оплавлением.

Второй тип Underfill материала дозируется по периметру микросхемы и за счёт капиллярного эффекта заполняет пространство под микросхемой. При температурной обработке компаунд отверждается, создавая прочную влагонепроницаемую защитную оболочку. Существуют ремонтпригодные и неремонтпригодные варианты.

Namics XSUF1589 неремонтпригодный underfill материал для защиты BGA микросхем

Namics XSUF1589 компаунд для защиты BGA микросхем от воздействия влаги и вибрационных нагрузок. Наносится под BGA микросхему после её монтажа на печатную плату. Компаунд дозируется по периметру микросхемы и за счёт капиллярного эффекта заполняет пространство под микросхемой. При температурной обработке компаунд отверждается, создавая прочную влагонепроницаемую защитную оболочку. Namics XSUF1589 после отверждения не позволяет осуществлять ремонт, но обеспечивает большую механическую прочность, чем ремонтпригодные аналоги.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Underfill материалы

Вязкость	10 Па.сек	
Цвет	чёрный	
Температура стеклования	120 °С	
КТР	23/80 мкм/м °С	α1/α2
Удельное электрическое сопротивление	>1x10 ¹⁶ Ом-см >5x10 ¹³ Ом-см	начальное после 20 часов при 121С, 2атм
Диэлектрическая проницаемость	3.4 1МГц	
Диэлектрические потери	0.7	
Ионные примеси	<0.1 ppm <0.1 ppm 5 ppm	Na+ K+ Cl-
Время жизни в шприце	24 часа	25 °С

Технология использования:

Метод нанесения	дозирование
Нанесение компаунда	
Температура подложки	< 70 °С
Тип иглы	18 - 23G
Отверждение компаунда	
Температура / время отверждения (на выбор):	150 °С / 3 минуты 120 °С / 20 минут

Условия поставки:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Underfill материалы

Поставка под заказ. Срок поставки от 6 до 12 недель.

Упаковка, хранение и транспортировка:

Namics XSUF1589 поставляется в шприцах для автоматизированного нанесения.

Условия хранения/срок годности: ниже -20С/6 месяцев

По вопросам приобретения **Underfill материалов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов